

## HP-603 型精密自动划片机

主要用于集成电路、发光二极管、铌酸锂、压电陶瓷、石英、砷化镓、蓝宝石、氧化铝、氧化铁、玻璃等材料的划切加工。

### 主要技术特点：

1. Y 轴采用滚动导轨，进口高密度定位电机，光栅尺闭环控制，无误差积累
2. 同时安装环形光 and 同轴光, CCD 监视对准系统。
3. 简单、友好的用户操作界面，具有刀具磨损自动补偿功能。
4. 进口空气静压主轴（交流），具有精度高、刚性好等特点。
5.  $\theta$  轴采用直驱交流伺服系统工作台，精度更高。



### 主要技术指标：

主轴	转速	3000~40000rpm	对准系统	照明光源	同轴+环形
	输出功率	1.5kW		放大倍率	150X~300X
X 轴	切割行程	Max230mm		显示器	15" 彩色 LCD
	切割速度	0.1~400mm/s	操作系统	控制系统	PC Base
Y 轴	切割行程	Max165mm		操作系统	Windows® 2000
	单步步进精度	0.003mm		语言	中文
	全程最大误差	0.005/165mm	加工尺寸	工作尺寸	Φ6"
Z 轴	有效行程/刀盘尺寸	Max20mm/Φ61 mm		圆形工作台	Φ6"
	重复定位精度	0.003mm		方形工作台	160mm × 160mm
	刀具应用尺寸	φ 50mm~φ 61mm	体积 (W× D× H)	600×865×1700 (mm)	
θ 轴	转角范围	Max320°	安装	净重	500Kg
	重复定位精度	±5"		电源	AC 220V±10%，三相

选配部件：该机型的进口主轴可以选用直流空气静压主轴，具有热变形小、摩擦小、寿命长等特点。